

堆叠研发流程及规范

编号： YD-BU2-MD-01

阶段	序号	阶段性工作描述	输 出	输出文件参考	相关流程及设计规范	责任人	完成时间	备注
项目评估阶段	1	根据平台或客户要求，初步堆叠，输出硬件\射频评估文件；	初步堆叠3D\DXF、EMN文件	略	 堆叠厚度分析对照表.xls	堆叠工程师		
	2	与组件工程师及sourcing工程师沟通确认，输出器件选型清单；	《XXXX堆叠主机电料清单》	 XXXX项目堆叠主机电料清单		堆叠工程师		
	3	结合初步堆叠评估结果，输出堆叠方案分析表；	《XXXX堆叠方案分析表》	 XXXX项目堆叠方案分析表		堆叠工程师		
	4	根据平台或客户提供的CMF图纸，完成供报价评估用结构BOM制作；	《XXXX项目结构报价BOM》	 XXXX项目结构报价BOM		堆叠工程师		
	5	根据平台或客户要求，按堆叠评估和CMF图纸，完成项目风险评估报告；	《XXXX项目风险评估报告》	 XXXX项目风险评估报告		堆叠工程师		
	1	细化堆叠设计,按堆叠3d设计规范指导完成堆叠的设计及细化；	FOR_ID\MD设计堆叠3D文件	略	 堆叠3D文件规范要求.doc  结构自检评审checklist	堆叠工程师		
	2	参照《结构自检评审checklist》堆叠部分自检堆叠，进行内部评审,输出内部评审；	《XXXX项目堆叠评审报告(结构部归档用)》	 XXXX项目堆叠评审报告		堆叠工程师		
	3	编写堆叠设计说明；	《XXXX项目堆叠设计概要说明》			堆叠工程师		

正式 立项 阶段	4	与硬件核对器件高度；	输出确认邮件			堆叠工程师		
	5	堆叠外部评审；	《XXXX项目堆叠评审报告(归档技术室用)》《堆叠checklist检查表》			堆叠工程师		
	6	参与LAYOUT评审，丝印、露铜等细节确认，输出拼板图等文件；	拼板图、屏蔽罩图纸	略		堆叠工程师		
	7	堆叠归档，按堆叠归档规范文件进行归档事宜；	堆叠归档要求文件	略		堆叠工程师		
EVT 阶段	1	贴片料\外围电声器件 索样及确认；新料的测试安排						
	2	配合硬件调试验证						
	3	涉及堆叠问题，需要给出分析及改善措施						
DVT	1	配合硬件PCB板改板，若拼板图需要更新，需要输出更新后拼板2D图纸并走OA升级归档	拼板图2D图纸\走OA升级归档	略				
	2	配合硬件DVT调试验证						

阶段	3	涉及堆叠问题，需要给出分析及改善措施						
	4	配合整机结构工程师DVT可靠性测试问题的分析解决						
PVT阶段	1	配合硬件调试验证						
	2	涉及堆叠问题，需要给出分析及改善措施						
	3	配合整机结构工程师可靠性测试问题的分析解决						
MP阶段	1	涉及堆叠问题，需要给出分析及改善措施						
	2	最终量产的堆叠文件归档	堆叠归档要求文件					